



美格智能 SRM810 模组

5G NR LGA封装小尺寸全功能模组

美格智能5G模组SRM810模组是一款专为IoT/电力/eMBB等应用而设计的国产化5G Sub-6GHz模组,该模组采用LGA封装,尺寸为30.0x41.0x2.7mm,采用了紫光展锐最新一代唐古拉V516国产芯片方案,符合3GPP Release 16标准,可支持5G独立组网(SA)和非独立组网(NSA)两种网络架构,支持国内所有运营商频段需求,并向下兼容4G/3G网络。该模组同时支持更安全的5G网络切片、us级5G高精度授时、5G LAN、UE节能等R16新特性,可为国内客户带来更完美的5G体验。

SRM810模组提供丰富的功能接口方便用户进行外设扩展,可支持USB3.0、PCIe2.0、SDIO、SPI、多路UART、ADC、GPIO等接口,内部预留eSIM支持;可适配多种类型操作系统(Android, Linux, Windows等),同时内置了丰富的网络协议,在尺寸、可靠性、散热等方面有较大优势,可广泛应用于eMBB、电力、工业互联网、智慧医疗、智慧城市等垂直行业。

主要优势:

- 超小尺寸,全功能,4天线极简设计
- 国产芯片及射频方案,高性能和高性价比
- 支持国内四大运营商,支持双卡功能
- 支持USB3.0、PCIe2.0、SDIO等高速接口
- 符合3GPP Release 16标准,支持SA&NSA,向下兼容4G/3G
- 支持更安全的5G网络切片、us级5G高精度授时、5G LAN、UE节能等新特性



5G NR



SA&NSA



LGA封装



USB3.0



PCIe 2.0



MIMO



-40°C-85°C



VoNR/VoLTE*

MeiG Smart SRM810模组

5G NR LGA封装小尺寸全功能模组

MEIG 美格

股票代码:002881

基本属性:

- 封装: LGA 封装
- 尺寸: 30.0×41.0×2.7mm
- 重量: <10g

模组速率:

- 5G NR Sub-6GHz:
 - MIMO 4*4, 256QAM
 - Downlink up to 2.0Gbps
 - Uplink up to 500Mbps
- LTE:
 - Downlink up to 400Mbps
 - Uplink up to 150Mbps
- DC-HSPA+:
 - Downlink up to 42.4Mbps
 - Uplink up to 5.76Mbps

驱动&工具:

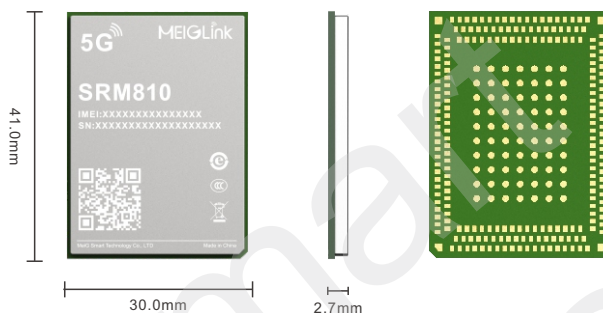
- 驱动: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Android
- 工具: 一键式升级工具, Gobinet拨号工具
- FOTA 升级

模组接口:

- 1xUSB 2.0/USB 3.0
- 1xPCIe Gen2.0
- 2xUART
- 1xSDIO 3.0
- 2xSIM卡接口(1.8 / 3.0V)
- eSIM
- 天线接口:主/分集/MIMO天线, 共4根
- 1xSPI
- 1xI2C
- GPIOs

认证信息:

- CCC*/SRRC*/CTA*



发射功率:

- Class 2 for N41/N78/N79
- Class 3 for LTE-FDD
- Class 3 for LTE-TDD

网络协议:

- RNDIS/NCM/IPv4/IPv6/TCP/UDP

环境温度湿度特性:

- 正常工作温度: -30°C to 75°C
- 扩展工作温度: -40°C to 85°C
- 存储温度: -40°C to 90°C
- 湿度: 5%~95%

SRM810系列频段信息:

5G NR NSA:N41/N78/N79
5G NR SA:N1/N8/N28/N41/N78/N79
LTE-FDD:B1/B3/B5/B8
LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41
WCDMA:B1/B8
5G DL 4x4 MIMO:N41/N78/N79

备注: * 研发中

